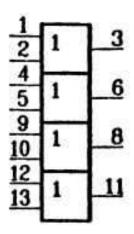
КР1533ЛЛ1, **КФ**1533ЛЛ1, **ЭКА**1533ЛЛ1, **ЭКФ**1533ЛЛ1

Микросхемы представляют собой четыре логических элемента 2ИЛИ. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г и 4306.14-А.

Назначение выводов: 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13 - входы 1D1, 1D2, 2D1, 2D2, 3D1, 3D2, 4D1, 4D2; 3, 6, 8, 11 - выходы Y1...Y4; 7 - общий; 14 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ЛЛ1, КФ1533ЛЛ1, ЭКА1533ЛЛ1, ЭКФ1533ЛЛ1

Таблица истинности

Вход		Выход
D1	D2	Υ
0	0	0
Χ	1	1
1	Χ	1

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	5 B ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня	≤ 0,4 B
Выходное напряжение высокого уровня	≥ (U _n - 2) B
Прямое падение напряжения на антизвонном диоде	≤ -1,5 B
Ток потребления при низком уровне выходного	
напряжения	≤ 4,9 mA
Ток потребления при высоком уровне выходного	
напряжения	≤ 4 mA
Входной ток низкого уровня	≤ -0,1 mA
Входной ток высокого уровня	≤ 20 мкА
Выходной ток	-30 -112 мА

Время задержки распространения сигнала	
при включении≤	12 нс
Время задержки распространения сигнала	
при выключении≤	14 нс
Емкость входа≤	5 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	.4,55,5 B
Входное напряжение низкого уровня	.00,8 В
Входное напряжение высокого уровня	.25,5 B
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	.5,5 B
Температура окружающей среды	10+70 °C

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °C; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °C; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более $265~^{\circ}\mathrm{C}$; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более $3~\mathrm{c}$; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее $1~\mathrm{mm}$; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее $5~\mathrm{mu}$ н.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов

производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °C.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °C.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения $5 \ B \pm 10\%$, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.